

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-003

宏和电子材料科技股份有限公司

关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体情况如下：

根据公司 2026 年度生产经营及投资发展的资金需求，为保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（不包括合并报表范围内子公司）2026 年度拟向银行等融资机构申请总额不超过人民币 16 亿元（含等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行等融资机构实际审批的授信额度为准），并有权以自有土地、房产等自有资产为公司设置抵押或质押担保。授信形式和范围包括但不限于项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行及商业承兑汇票之开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、资金及外汇管理业务、贸易融资、融资租赁等综合授信业务。具体业务品种、授信形式和范围、授信额度、授信期限等以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述预计综合授信额度包括新增授信及原有授信展期，不含之前已审批通过的其他单独审议的授信事项。

上述授信期限自股东会审议通过之日起一年，授信期限内，该授信额度可以循环使用。在有效期内，公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件，并授权董事长或其指定的授权代理人具体办理上述综合

授信额度内的具体授信及贷款业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关协议和文件。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月24日